

# T6 Series (TF611/TG611)

T6 series are the Laser Microprocessing Machine for brittle materials mainly in LED industries. This brand new series enable high-quality and high-speed processing.

T6 シリーズは、主に LED 業界向けに開発された脆性材料を加工するレーザー装置です。

従来の R5 シリーズより、高品位・高速の加工性を実現しています。

T6 series provides super precise and smooth X/Y scribe by unique optical system and automatic alignment function.

独自の光学系と自動アライメント機能の採用により、スムーズ、且つ、超高精度な X/Y スクライブを実現しています。



The outside appearance and specifications are subject to change without notice.

外観、仕様は予告なしに変更になることがあります。

# Laser Microprocessing Machine

レーザー微細加工装置 T6 シリーズ

## T6 Series (TF611/TG611)

### T6 Specifications

MODEL		TF611	TG611
Laser Head	レーザーヘッド	MDI HB Laser	UV355 Laser
Wafer Size	対応ウエハサイズ	2~6inch (/8inch ring)	
Scribe Velocity	処理速度	500mm/sec. Max	
Operating System	動作制御	PCWindows®OS	
Dimensions(WxD×H)	装置寸法	1,300×1,500×1,850mm	
Weight	重量	approx. 2,200kg	

### Applications

LED , other Electronic components , etc.

### Contact

[www.mitsuboshidiamond.com](http://www.mitsuboshidiamond.com)

※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners.  
※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※The specs are subject to change without prior notice.  
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。